

报价文件开标记录表

项目编号	ZJWSBJ-ZDCY-2023033G	项目名称	芯片制造虚拟实景实训实验室
采购方式	公开招标	开标时间	2023-07-03 13:00:00
开标地点	政采云平台		
序号		供应商名称	报价(元)
1		杭州融至兴科技有限公司	1060000（壹佰零陆万元整）
2		杭州旭云信息技术有限公司	1056000（壹佰零伍万陆仟元整）
3		杭州凌顺信息技术有限公司	1065000（壹佰零陆万伍仟元整）